

ENG. NO. SD-52018-4**5
EDP NO. —#—

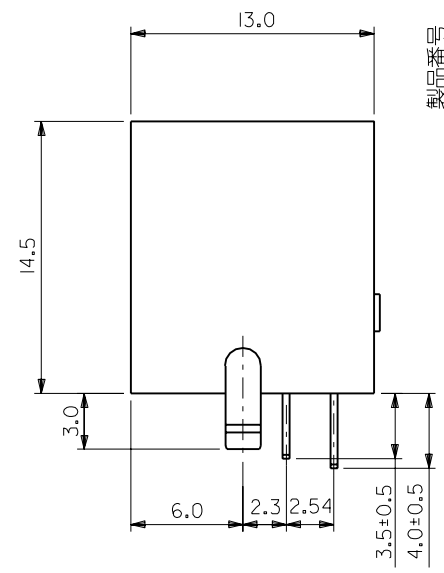
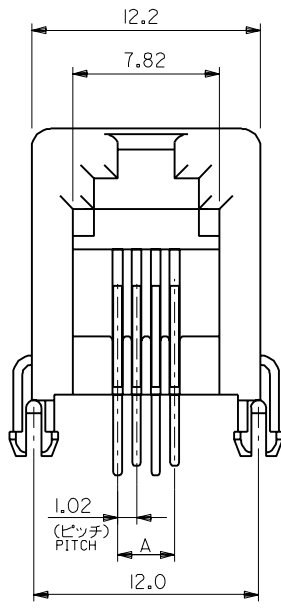
MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

USA IET 110.3J552018G4.DGN

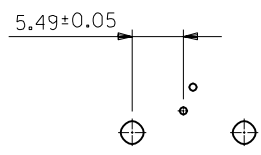
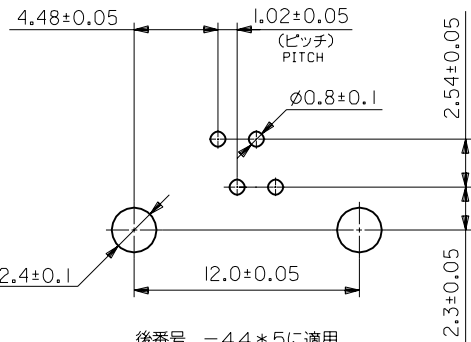
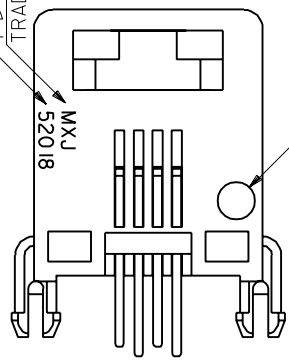
52018G4.DGN

注) NOTES

- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリイエステル UL 94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
- メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0µmMIN.
- 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
- 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN.
YELLOW: 0.1µmMIN.
緑色: 0.38µmMIN.
GREEN: 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN.
ORANGE: 0.76µmMIN.
無色: 1.27µmMIN.
UNMARKED: 1.27µmMIN.
- ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.



製品番号
ENG.No.
トレードマーク
TRADE MARK



後番号 -44*5に適用
ENG NO. SUFFIX -44*5

基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

後番号 -42*5に適用
ENG NO. SUFFIX -42*5

角度 ANGLE	±3°						
30以上 OVER	+0.3	C	変更 REVISD (JC70240)	K.H	M.F	96/8/29	
10以上 30未満 UNDER	+0.25	B	再作図及び変更 REDRAWN & REVISED (JC60607)	K.H	M.F	96/3/8	
10未満 UNDER	+0.2		記号 LTR 変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	DATE		
一般公差 GENERAL TOLERANCES		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM					

4	4	3.05	1.27	52018-4445
			0.76	-4435
			0.38	-4425
			0.1	-4415
4	2	1.02	1.27	52018-4245
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	(A)	金メッキ厚 (µmMIN.) GOLD PLATING THK(MIN.)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO.	—#—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	ENG. NO.	SD-52018-4**5
被覆外径 INS. RANGE	—#—	TITLE 名称	MODULAR JACK HOUSING ASS'Y
DRAWN BY '96/3/8 K.HARADA	CHK'D BY '96/8/29 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	4-1
APP'D BY '96/8/29 M.FUKUSHIMA	DATE		

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8